

4971 **メック**

前田 和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

本社、研究所、生産を集約した新社屋が竣工

◆通期の連結業績予想を修正

1月31日付で、平成29年3月期の通期連結業績予想を修正した。営業利益は当初予想の20億円を18億円に修正しており、粗利の減少(約1億円)、販管費の増加(約1億円)が要因である。粗利については、単体の売上減少分が約60百万円、製品ミックスによる減少が約35百万円となっている。販管費については、本社、研究所、生産を集約した新社屋(尼崎事業所)に係る設備計画の一部(什器類など)を費用計上に変更したことで約70百万円増加したほか、子会社の人件費が約20百万円増加する見込みである。なお、当期純利益については、第3四半期の実績が14億70百万円となったが、第4四半期は営業利益の減少に加え、第3四半期と比較して法人税等が2億6百万円増加するため、当初予想の14億50百万円を据え置いた。

第3四半期の連結売上高は68億65百万円(前年同期比1億12百万円増)となった。内訳は、薬品が65億38百万円(同7百万円増)、機械が1億3百万円(同16百万円増)、資材が2億5百万円(同85百万円増)となっている。売上総利益は45億31百万円(同36百万円増)となった。販管費は29億59百万円(同65百万円増)となっており、事務用品・消耗品の増加による。この結果、営業利益は15億72百万円(同29百万円減)となった。経常利益は15億93百万円(同47百万円減)となったが、子会社留保金に対する税効果額の減少、日本の税率低下により、法人税等が1億37百万円となったため、四半期純利益は14億70百万円(同2億73百万円増)となった。なお、前年同期からの為替による影響は、売上高で5億2百万円減、営業利益で36百万円減となる。

貸借対照表の資産の部では、流動資産のその他が前期末比で2億円増加しており、これは尼崎事業所建設に伴う消費税額と売上にかかる消費税の差額が未収となったためである。固定資産の建物および構築物は、尼崎事業所の完成により、前期末の12億50百万円から40億41百万円に増加した。機械装置および運搬具も同様の理由で増加している。土地については、為替差により若干減少した。建設仮勘定の減少は、尼崎事業所に係るものである。投資有価証券は、保有株式の時価上昇により増加した。

負債の部では、流動負債合計が28億11百万円となった。主な内訳としては、1年内返済予定の長期借入金が5億円となっており、尼崎事業所の建設資金の借入を実施した。設備関係支払手形および設備関係未払金は、尼崎事業所の建設に伴って増減が発生している。固定負債については、長期借入金が12億50百万円となった。なお、尼崎事業所建設資金の借入総額は20億円となっており、このうち2億50百万円を返済している。繰延税金負債の減少は、主に子会社留保金に対する税効果額の減少によるものである。純資産の部では、株式報酬制度の会計処理に伴って自己株式から資本剰余金への振替を実施した。

◆「CZ-8100」の売上高が回復

当第3四半期のトピックスとして、為替(USドル)については、想定レート105円に対して実勢レートが109.97円となり、円安に進捗したが、前年(120.84円)との比較では円高となっている。薬品の出荷量は前年同期比で微増となった。海外売上高比率は53.7%(前年同期実績54.9%)となっており、海外使用分の国内代理店販売を海外

売上高に加算した場合の比率は 72.8% (同 75.8%) となる。「CZ」の売上高は 34 億 2 百万円となり、薬品売上高に占める割合は 52.0% となった。粗利率は前年同期の 66.6% から 66.0% に低下した。

品種別売上高構成比については、薬品が全体の 95.2% を占めている。薬品別では、銅表面処理剤が大部分を占め、当四半期は「CZ シリーズ」を中心とした密着向上剤、「EXE シリーズ」を中心としたエッチング剤ともに前四半期比で増加した。CZ シリーズの状況として、「CZ-8100」については、第 2 四半期まで売上高が減少傾向にあったが、車載など一般基板への採用が進み、当四半期は回復した。「CZ-8101」は、第 2 四半期とほぼ同水準の売上高となった。地域セグメント別売上高については、欧州が前四半期比で若干減少したものの、日本、アジアは前四半期を上回った。

第 4 四半期の見通しとしては、単体(日本)の売上高が減少する見込みである。第 3 四半期までは、韓国向けやタッチパネル関連でカバーしていたが、第 4 四半期は、テレビのモデルチェンジの兼ね合いで、当社がデファクトスタンダードを獲得している COF 用 EXE の出荷が減少すると予想している。ただし、これは一時的なものであると考えている。

◆「EXE シリーズ」に期待

当社のコア技術は、配線を形成する技術 (EXE など)、表面を粗化して密着性を向上させる技術 (CZ、V ボンドなど)、選択エッチング技術である。尼崎事業所の竣工により、研究スペースが広くなり、機械も充実させたため、今後はこれらのコア技術を太くしていきたいと考えている。

当社の製品は、自動車、通信インフラ、TV など、さまざまな用途向けの電子基板・部品に使われている。現在は、IoT や AI 社会の入口にあるが、今後は IoT によってさまざまな機械がつながり、現実世界のビッグデータがサイバースペースの AI によって分析され、社会の課題解決に活用されるようになる。2020 年頃から 5G やコネクテッドカーが立ち上がり、センサ、プロセッサ、高周波基板が増加するため、新たな製品の研究開発に力を入れ、ニーズを掘り起こしていきたい。

IoT を機能させるためには、現在の 4G では能力が不足しており、2020 年から立ち上がる 5G に負うところが大きい。機械と機械をつなぐ場合、一瞬の遅れが致命的となるため、高速通信・低遅延が重要となる。また、大容量化も必須であり、大きなネットワークの変革が起きる。自動運転については、半導体メーカーと自動車・自動車部品メーカーが手を組む傾向にあり、当社にとってメリットがある。ミリ波レーダー基板は高密度となっており、ビルドアップで作られているため、CZ シリーズやフラット処理の有望な市場になると期待している。

EXE シリーズは、高いエッチングファクターで配線ボトムの裾引きが少ないという特長を持っている。既に COF 用で高いシェアを確保しているが、エッチング剤に添加するだけで使用可能であり、サブトラクティブ法で高密度化が可能となるため、さらなる採用拡大が期待できる。

高速伝送対応基板用密着向上剤「フラットボンド」は、基地局やスパコン用マザーボードに新規採用された。まだ量は少ないが、フラット処理では当社が最も進んでおり、顧客の要求に応える実力を有しているため、今後の業績向上に寄与すると見ている。

フレキシブル基板の高密度化についても、当社の薬品の採用が進んでおり、将来に向けた評価・実験も行われている。ドライフィルムの前処理に使われる「UT シリーズ」は、電解銅箔、圧延銅箔とともに、ムラなく粗化することができるため、フレキシブル基板以外の顧客からも注目されている。「アマルファ」は、携帯端末の金属とプラスチックの直接接合に使われており、今後は人気機種への採用を目指す。

◆事業領域を拡大

本社社屋については、予定通り 2016 年 10 月に竣工した。12 月 26 日に本社機能を移転したため、第 4 四半期から本格的な減価償却が始まる。2017 年 1 月には研究開発業務を開始しており、既存のリソースを大事にしながら

ら、新たな分野にチャレンジしていく。4月1日からは、生産機能も本格稼働となる。西宮工場の機能を移転する予定だが、顧客の認定を取得する必要があるため、当面、西宮工場と併用していく。新社屋に本社、研究所、生産を集約したことで、コミュニケーションが取りやすい環境となったため、開発のスピードアップにつなげ、顧客のニーズに応えていきたい。

事業領域の拡大については、電子基板製造関連分野で技術の変化に対応し、収益を確保するとともに、ディスプレイ関連分野、樹脂金属接合関連分野にチャレンジしていく。当社の経営戦略の根幹は、技術マーケティングの強化、オープンイノベーションの推進、ESG 戦略の推進である。今後も関係先とのコラボレーションにより、求められているものを効率よく開発していきたい。

◆ 質 疑 応 答 ◆

尼崎事業所関連費用の詳細を伺いたい。

減価償却費については、当初、第3四半期から発生する予定であったが、稼働が遅延したため、第4四半期から発生する(約50百万円)。一過性の費用としては、什器などの費用計上を第3四半期に実施した。引越費用は、第3四半期に本社および工場の約10百万円を計上しており、第4四半期に研究所の約60百万円を計上する。

為替の影響もあって、売上高100億円の手前で足踏みしているように見えるが、今後、期待できる薬品を教えてください。

最も期待しているのは EXE シリーズであり、HDI 用の採用が増加する見込みである。また、フレキシブル基板関連で UT シリーズにも期待できる。

(平成 29 年 2 月 2 日・東京)

* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

<http://www.mec-co.com/ir/library/>